【19】中華民國　　【12】專利公報　（S）

【11】證書號數：D246926
【45】公告日： 中華民國 115 (2026) 年 10 月 01 日
【51】LOC. (15) Cl.：13-99

設計　　全8 頁

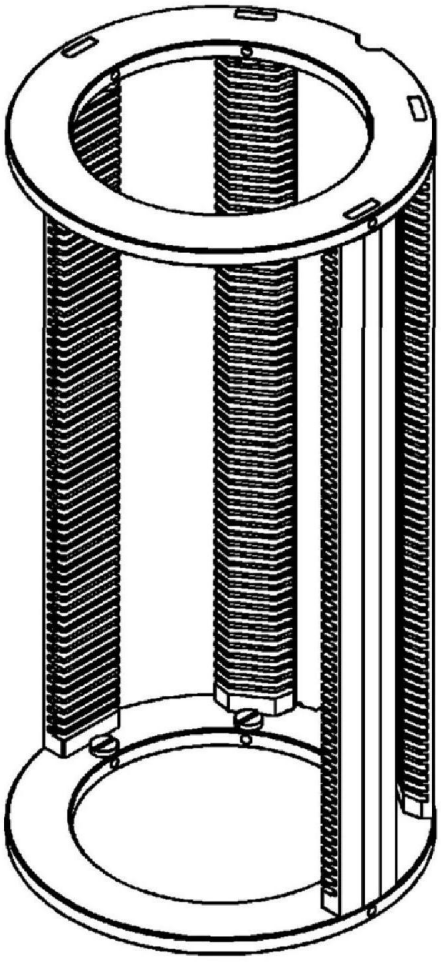
【54】名　　稱：半導體製造用晶圓支持具
【21】申請案號：114301647　　【22】申請日： 中華民國 114 (2025) 年 04 月 11 日
【30】優 先 權： 2024/10/15　　日本　　2024-021335
【72】設 計 人： 原大介 (JP) HARA, DAISUKE
【71】申 請 人： 日商國際電氣股份有限公司　　KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
日本
【74】代 理 人： 林志剛
【56】參考文獻：

TW	350721	TW	M661024
TW	D130137	TW	D197468
CN	300696145	CN	300750696
CN	300764180	KR	3002311990000
KR	3002311990001	US	D411176
US	D791721	US	D893438

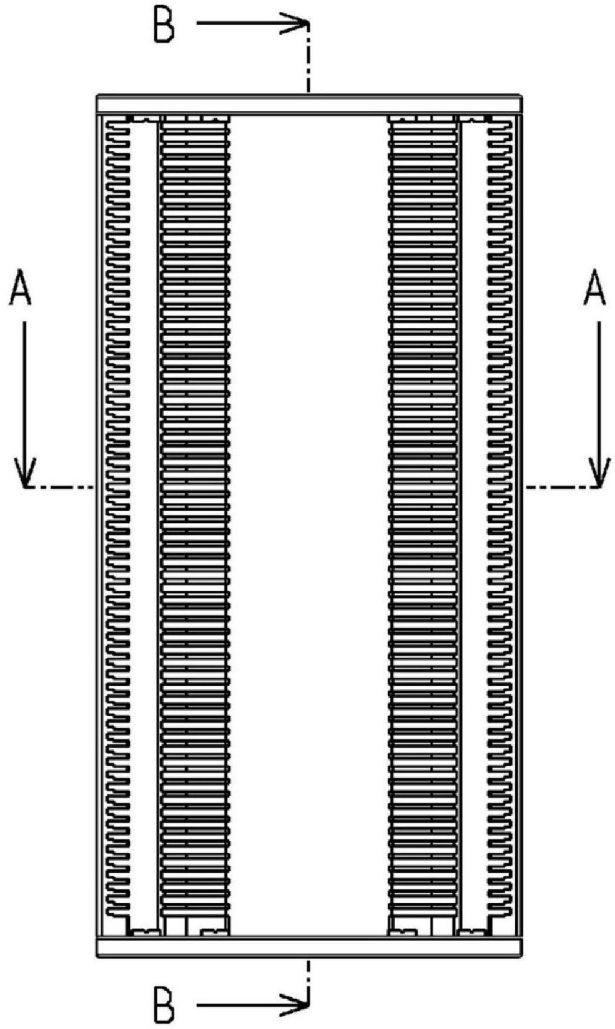
審查人員：蔡垂宏

設計說明

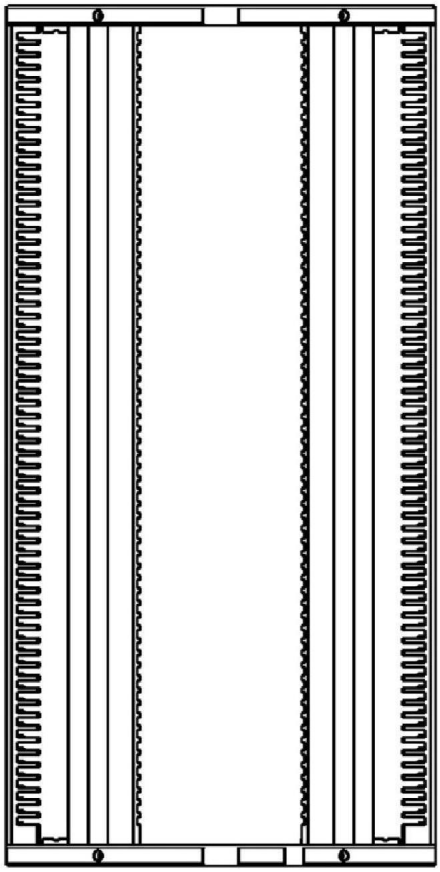
左側視圖與右側視圖相對稱，左側視圖省略。



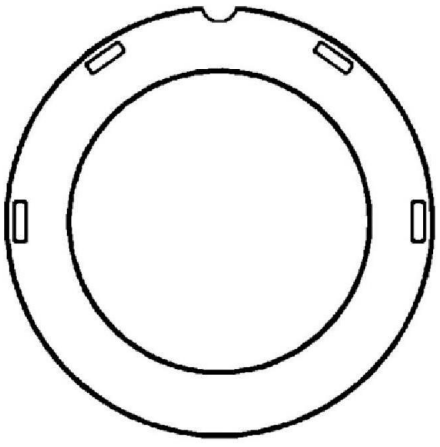
【背面立體圖】



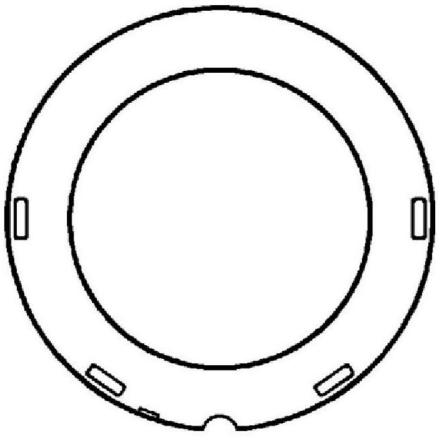
【前視圖】



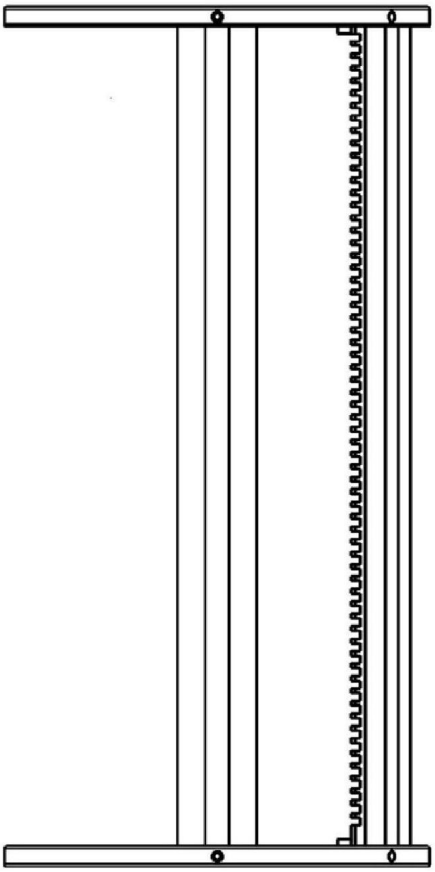
【後視圖】



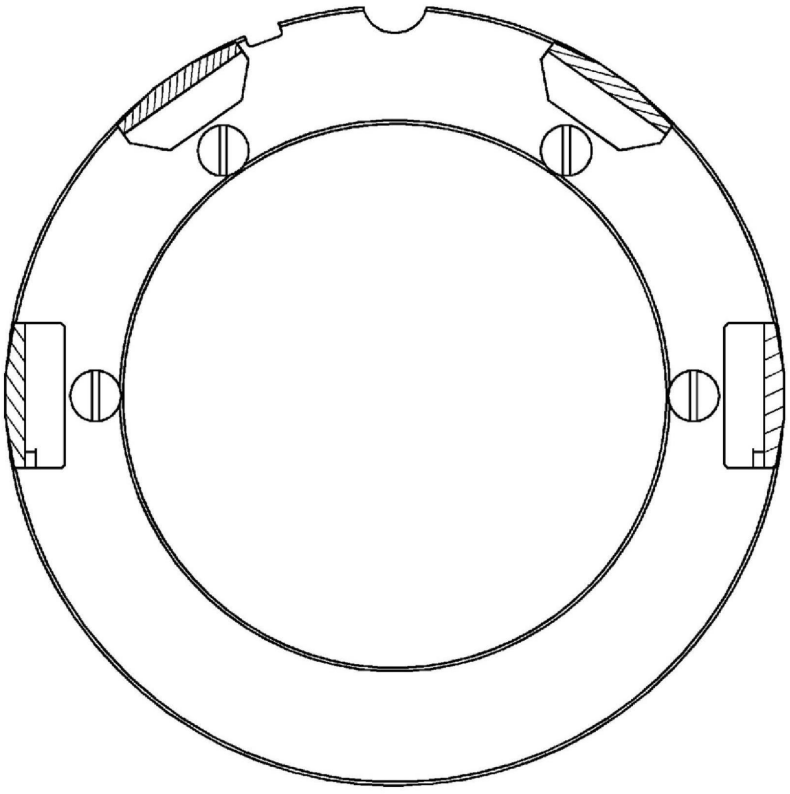
【俯視圖】



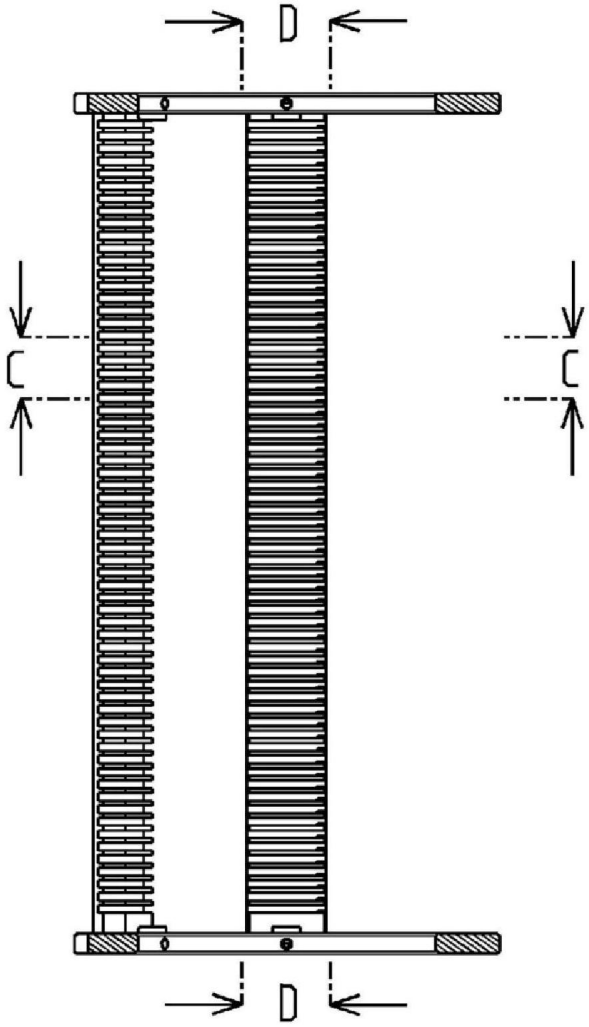
【仰視圖】



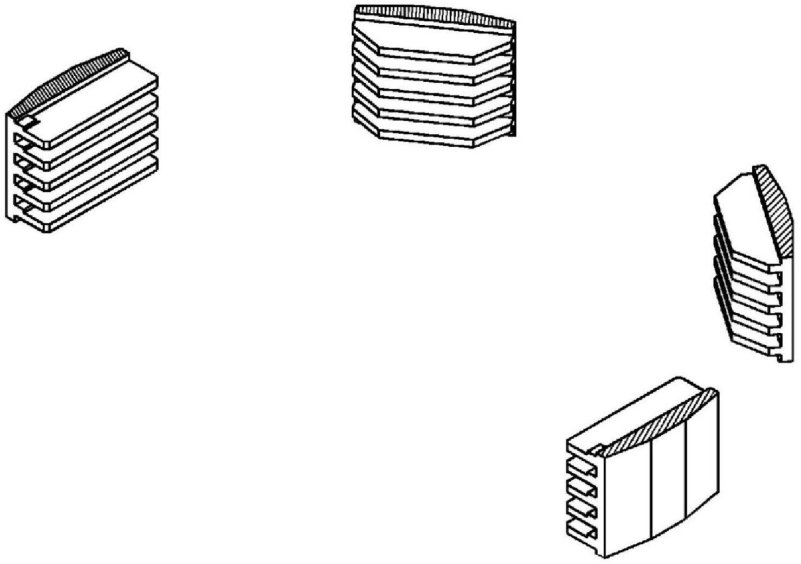
【右側視圖】



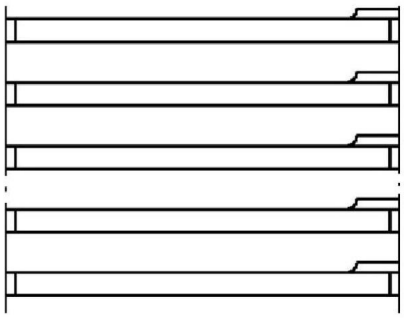
【A-A線放大剖面圖】



【B-B線剖面圖】



【C-C部分放大立體圖】



【C-D部分放大圖】